

国泰君安证券股份有限公司
关于无锡芯朋微电子股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为承接无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“芯朋微”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯朋微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与芯朋微签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解芯朋微经营情况，对芯朋微开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年 1-6 月，芯朋微在持续督导期间未发生按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年 1-6 月，芯朋微在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在持续督导期间，保荐人督导芯朋微及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺

序号	工作内容	持续督导情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促芯朋微依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对芯朋微的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，芯朋微的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促芯朋微严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐人对芯朋微的信息披露文件进行了审阅，不存在因信息披露文件出现问题应向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年 1-6 月，芯朋微及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年 1-6 月，芯朋微及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年 1-6 月，经保荐人核查，芯朋微不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；	2023 年 1-6 月，芯朋微未发生相关情况

序号	工作内容	持续督导情况
	（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	2023 年 1-6 月，芯朋微不存在需要专项现场检查的情形
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年 1-6 月，芯朋微及相关主体在持续督导期间未出现该等情况

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代风险

集成电路设计行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并制定新技术的研究方向，或研发速度不及行业技术更新速度，公司可能会面临芯片开发的技术瓶颈，对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。

2、新产品研发失败风险

公司研发支出较大，2023 年上半年度研发费用为 9,008.10 万元，占营业收入的比例为 23.44%。集成电路设计行业需要对市场需求进行预判，研发出符合市场需求的产品，推广使用。若未来市场需求发生重大变化或公司未能开发出满足客户需求的产品，公司将存在新产品研发失败的风险，前期投入的研发费用可能无法全部收回。

3、核心技术泄密风险

芯片产品属于技术密集型产品，产品设计方案存在被竞争对手抄袭的风险。公司可能存在知识产权被侵权的风险，从而对公司产品的价格、技术产生不利影响。

（二）市场和经营风险

1、市场竞争加剧的风险

从整体市场份额来看，目前国内功率半导体市场的主要参与者仍主要为欧美企业，占据了 80%以上的市场份额，因此国内企业目前尚无法与德州仪器（TI）、英飞凌（Infineon）、意法半导体（ST）等企业在产销规模上竞争。同时，国内 IC 设计行业发展迅速，参与数量众多，市场竞争日趋激烈。公司产品市场占有率较低，在技术实力、市场份额方面和境外竞争对手相比均存在差距，面临较大的国内外品牌的竞争风险。若竞争对手利用其品牌、技术、资金优势，加大在公司所处市场领域的投入，可能对公司市场份额和销售额形成挤压，从而影响公司的盈利能力。

2、客户认证失败的风险

公司芯片产品需要通过客户测试认证才能进入批量供应。因下游产品存在更新迭代，不论新老客户，每年都会有多款新产品需要进行客户认证，若客户测试认证失败，存在客户选择其他公司产品进行测试认证的可能，从而导致该款芯片不能在客户该款产品中形成销售。若公司连续多款产品在同一客户中认证失败，有可能导致客户对公司产品品质产生质疑，从而导致公司不能获得新客户或丢失原有客户，导致公司收入和市场份额下降，进行对公司盈利能力产生不利影响。

3、产品质量的风险

公司所从事业务的技术含量较高，行业的进入壁垒也相对较高，但同时也对公司研发、管理提出了更高难度的要求，从而使公司存在一定的产品质量风险。随着行业内对产品不良率要求的提高，若在上述环节中发生无法预料的风险，可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。

4、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司前五大供应商的采购占比为 87.18%，公司供应商集中度较高。如果上述供应商产能紧张、提价或由于某种原因停止向公司供货，将导致公司短期内产品供应紧张或成本上升，从而对公司盈利能力产生不利影响。

（三）行业风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近些年一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

（四）宏观环境风险

报告期内，受到地缘政治形势以及通货膨胀等因素的叠加影响，消费电子领域市场规模受到了较强的冲击。终端销量的下滑也让下游客户在备货策略上更为保守，新产品的推出时间有一定程度的后延。

（五）其他重大风险

1、政府补助不能持续的风险

报告期内，公司政府补助金额占利润总额的比例较大。政府补助计入公司非经常性损益，且公司未来能否持续获得大额政府补助存在不确定性，公司存在因政府补助波动导致净利润波动的风险。

2、实际控制人风险

张立新先生持有公司 30.27%的股权，为公司实际控制人，对公司重大经营决策有实质性影响。若实际控制人用其控股地位，对公司经营决策、利润分配等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。

四、重大违规事项

2023 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理解释

2023 年 1-6 月，公司主要财务数据如下所示：

主要会计数据	2023 年 1-6 月 /2023 年 6 月 30 日	2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日	增减变动幅度（%）
营业收入（元）	384,272,174.72	375,400,560.99	2.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,076,775.11	58,337,836.59	-17.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,189,191.66	45,349,507.52	-26.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,823,099.65	17,471,716.76	-60.95
	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,505,807,493.89	1,470,726,007.29	2.39
总资产（元）	1,896,085,730.43	1,720,140,222.40	10.23
主要财务指标	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.42	0.52	-19.23
稀释每股收益（元 / 股）	0.42	0.51	-17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.40	-27.50
加权平均净资产收益率（%）	3.24	3.84	减少 0.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.24	2.98	减少 0.74 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	23.44	23.33	增加 0.11 个百分点

上述主要会计数据和财务指标变动的原因如下：

经营活动产生的现金流量净额同比减少 60.95%，主要系公司人员规模增大、人均薪资提升导致薪酬费用增加所致。

综上，公司 2023 年 1-6 月主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化

公司的核心竞争力包括：

（一）基于核心技术平台的产品布局和阶梯式增长模式

1、先进的“高低压集成技术平台”

公司成立之初，专注于技术平台的开发，对当时国内空白、难度很大的“700V 单片高低压集成技术平台”启动研发，从特殊高压半导体工艺和器件平台技术开始研发试验，再到电路、版图和系统设计，历时两年，研发完成了 700V 单片 MOS 集成 AC-DC 电源芯片系列，能够很好地帮助整机客户达到全球日益严苛的电子设备电源待机功耗标准，并在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案，打破了进口产品的垄断。多年来，公司对该技术平台持续投入，迭代更新，目前量产品种已逐步从第三代“智能 MOS 超高压双片高低压集成平台”，升级至第四代 Smart-SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart-GaN 的全新智能功率芯片技术平台。公司通过持续的研发投入保证核心技术平台的先进性，以保证芯片产品的技术优势。

2、基于自研器件工艺基础平台的可靠性技术

公司除了芯片设计人才之外，还拥有半导体器件和工艺制造方面的专家团队，在晶圆制造工艺和半导体器件技术方面积累深厚，因此公司在产品生产环节中能够更好地与晶圆供应商深度协同，指定供应商采购符合芯片性能的原料，制定更优的器件结构，与供应商共同研发优化改进晶圆供应商的工艺流程并形成独有的工艺从而对竞争对手形成技术壁垒，通过质量工程师对芯片的器件工艺参数进行及时质量监控，并定期对供应商的内部质量系统运作情况进行审核把关，从晶圆生产加工方面提升了芯片的性能和可靠性，通过量产前严格的试产检验，降低早期失效的几率，保证产品的质量、降低生产成本。同时公司基于 ISO22301 业务连续性管理体系 BCMS 要求，深入开展业务连续性的升级优化，扩大并赋能多层次供应商，提升交付水平。

3、基于技术平台的产品布局和阶梯式增长模式

基于不断升级的核心技术平台，公司产品线不断丰富，收入规模和盈利水平稳步上升。2023 年，针对白电冰空洗市场，公司持续完善驱动芯片、功率器件等系列产品，在 AC-DC 产品已覆盖的整机上搭配 Gate Driver(HV&LV)、IGBT，提升公司在白电市场的 SAM；针对手机品牌商市场，公司自主研发的高集成快充初级控制功率芯片、次级同步整流芯片及 PD 协议芯片的全套片方案逐渐上量，下游应用场景从 10W 到 200W、从硅基到氮化镓全覆盖；针对工业级电源市场，

开发了新一代高性能、高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理及驱动芯片，并逐步形成系列化产品，为工业级通讯设备电源管理及驱动芯片领域实现自主可控做出贡献。公司始终有序的依托核心技术平台，不断拓展新的产品线，不断拓展业务增长路径，扩大下游行业应用范围，实现阶梯式稳步增长。

公司主要产品覆盖了电源管理芯片的大部分技术种类，产品应用市场覆盖了家用电器、标准电源以及工业设备等重点领域，随着公司产品线的丰富完善，已实现从过去单一提供高压电源管理芯片，逐步发展为向客户整机系统提供从高低压电源、驱动及其配套器件/模块的功率全套解决方案。同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、Gate Driver (HV&LV)、IGBT 等多品类功率半导体芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升公司各产品线的协同效应，提高销售效率。

（二）技术团队研发优势

1、高水平的研发团队

公司成立 18 年来始终专注于功率半导体芯片研发，以自主创新为经营核心宗旨，研发实力突出，特别在高低压集成半导体技术方面具有优势。公司参与了《家用电器待机功率测量方法》、《智能家用电器通用技术要求》和《智能家用电器系统架构和参考模型》等多项国家技术标准的起草制定，获得了 2020 年度国家技术发明奖二等奖、“第六届中国半导体创新产品”、2019 年第十四届“中国芯-优秀技术创新产品奖”、2019 年度“江苏省科学技术一等奖”等多项行业荣誉奖项和国家重点新产品认定。公司拥有博士后企业工作站和江苏省功率集成电路工程技术中心。

公司核心技术管理团队经验丰富，形成了有序稳定的中青年人才梯队。目前，公司已形成了一支拥有 5 名博士领衔，共计 245 人的高水平研发团队，占公司员工比例 72.27%。

2、持续的研发投入及丰富的技术积累

公司自成立以来一直重视研发投入，报告期公司研发费用投入为 9,008.10 万元，占公司营业收入的比例为 23.44%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计取得国内外专利 93 项，其中发明专利 75 项，另有集成电路布图设计专有权 123

项。公司在模拟和数字电路设计、可靠性设计、半导体器件及工艺设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术,形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势,多项芯片产品为国内首创,替代进口品牌,快速占领市场。

（三）基于行业标杆客户的产品推广模式

公司产品在整机/模块产品中获得了知名终端客户的认可可是打入进口品牌所控制市场的前提,为公司的业务发展打开了广阔的空间。下游应用行业的标杆客户收入规模大、产品种类齐全,是下游行业产品发展的引领者。公司产品获得行业标杆客户的认可后,有利于得到下游行业其他客户的认可,引导其替代进口产品。

（四）产业链协同和区位优势

公司总部位处长三角地区,是中国集成电路产业的传统优势区域,周边配套产业链完备,有利于公司与上游芯片制造、封装厂商实现产业链协同。公司与华润微电子、华天科技、长电科技等业内主流晶圆制造及封装测试厂商建立起了密切的合作关系,共同开发了多种特色工艺,更好地保证了公司产品的工艺优势,实现了公司产品的供货及时性、高可靠性和低上机失效率。

综上所述,2023 年 1-6 月,公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

为保证公司能够不断进行技术创新,保持产品的技术领先水平,维持公司的市场竞争优势,公司持续进行研发投入。

2023 年 1-6 月,公司研发投入 9,008.10 万元,占公司营业收入的 23.44%,较上年同期增长 2.84%。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计取得国内外专利 93 项,其中发明专利 75 项,另有集成电路布图设计专有权 123 项。其中,2023 年上半年度获得新增授权专利 8 项,新增集成电路布图设计 12 项。

报告期内,公司获得的知识产权如下:

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)

发明专利	13	8	168	75
实用新型专利	2	0	33	18
外观设计专利	-	-	-	-
软件著作权	-	-	1	1
其他	29	17	263	162
合计	44	25	465	256

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1216号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 A 股 28,200,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 28.30 元，共募集资金 798,060,000.00 元，扣除发行费用（不含税）75,568,924.28 元后，实际募集资金净额为 722,491,075.72 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具的苏公 W[2020]B069 号《验资报告》验证。

2023 年上半年公司投入募集资金 3,330,882.41 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述募集资金已全部使用完毕，具体详见公司 2023 年 3 月 17 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备注
中信银行无锡滨湖支行	8110501012201559911	0.00	已注销
招商银行无锡新区支行	510904133110101	0.00	已注销
招商银行无锡新区支行	510904133132501	0.00	已注销
交通银行无锡新区支行	322000640013000353108	0.00	已注销
工商银行无锡梁溪支行	1103020129200037665	0.00	已注销
兴业银行无锡新吴支行	408450100100216923	618.98	余额为季度结息，近期将注销
江苏银行无锡诚业支行	24410188000208205	5855.45	余额为季度结息，近期将注销
合 计		6,474.43	

公司 2023 年上半年募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，芯朋微控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

（一）直接持股情况

截至 2023 年 6 月 30 日，芯朋微控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持股情况如下：

股东名称	职务	持股数量（股）	持股比例
张立新	董事长、核心技术人员	34,301,000	30.27%
易扬波	董事、总经理、核心技术人员	4,662,000	4.11%
薛伟明	董事	1,557,000	1.37%
李海松	副总经理、核心技术人员	120,000	0.11%
曾毅	副总经理	108,000	0.10%
鲁建荣	监事	80,000	0.07%
易慧敏	财务总监、董事会秘书	33,000	0.03%
祝靖	副总经理	12,000	0.01%

（二）间接持股情况

截至 2023 年 6 月 30 日，芯朋微控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员间接持股情况如下：

股东名称	职务	间接持股主体	持股数量（股）
易扬波	董事、总经理、核心技术人员	无锡芯朋微电子股份有限公司第一期员工持股	145,000
李海松	副总经理、核心技术人员		
曾毅	副总经理		

祝靖	副总经理	计划	
易慧敏	财务总监、董事会秘书		
鲁建荣	监事		
徐梦琳	监事		

（三）质押、冻结及减持情况

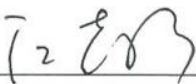
截至 2023 年 6 月 30 日，芯朋微控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的芯朋微股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

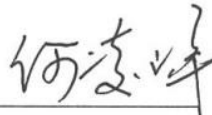
十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


江志强


何凌峰

国泰君安证券股份有限公司

